

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-77

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	东方证券、博时基金、猎投资本、天风证券、睿智产业投资
上市公司接待人员	证券事务主管：阳佩琴；投资者关系经理：郭家旭
时间	2024年12月25日
地点	东方证券策略会举办地
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。</p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。</p> <p>Q2、请介绍 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。</p> <p>伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，新一代信息技术产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求均受到上述趋势的影响。</p> <p>Q3、请介绍公司是否具备 HDI 工艺技术能力。</p>

HDI 作为一项平台型工艺技术，可实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。

Q4、请介绍公司 PCB 业务今年前三季度在数据中心领域的布局拓展情况。

数据中心是公司 PCB 业务重点布局领域之一，聚焦服务器、存储及周边产品。2024 年前三季度，全球主要云服务厂商资本开支规模明显回升，并重点用于算力投资，带动 AI 服务器相关需求增长，叠加通用服务器 Eagle Stream 平台迭代升级，服务器总体需求回温。在此期间，公司数据中心领域订单同比显著增长，主要得益于 AI 加速卡、Eagle Stream 平台产品持续放量等产品需求提升，产品结构有所优化。在新产品预研方面，公司已配合下游客户开展下一代平台产品研发、打样工作。

Q5、请介绍公司对汽车电子市场的布局逻辑以及技术优势。

与传统汽车电子产品相比，公司所聚焦的新能源和 ADAS 领域对 PCB 在集成化等方面的设计要求更高，工艺技术难度有所提升。例如 ADAS 领域相关产品对车载通信及数据处理能力要求更高，涉及高频材料、HDI 工艺、小型化等复杂设计。伴随汽车电动化/智能化趋势的延续及未来车联网等终端应用的涌现，汽车也可能演变为新型的移动数据终端，公司在通信领域积累的技术优势可进一步延伸。

Q6、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。

Q7、请介绍公司在封装基板领域的产品布局情况。

公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力。另一方面，针对 FC-BGA 封装基板产

	<p>品，公司通过近年来持续的技术研发工作，已实现部分产品的技术能力突破，相关客户认证及产能建设工作取得进展。目前，公司已成为内资最大的封装基板供应商。</p> <p>Q8、请介绍广州封装基板项目连线爬坡进展。</p> <p>公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年持续快速提升，已承接部分产品订单。目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作，其认证周期相较其他 PCB 及封装基板产品所需时间更长。</p> <p>Q9、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。</p> <p>公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品制造能力，其中 20 层产品送样认证工作亦有序推进中。</p> <p>Q10、请介绍公司近期产能利用率情况。</p> <p>公司近期综合产能利用率较 2024 年第三季度保持平稳。</p> <p>Q11、请介绍公司业务目前是否涉及玻璃基板产品。</p> <p>玻璃基板与 PCB、有机封装基板在材料特性、生产工艺方面均存在差异，在各自的应用领域具有不同特征。公司对玻璃基板技术保持密切关注与研究，目前不涉及玻璃基板的生产。</p> <p>Q12、请介绍请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。</p> <p>公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2024 年上半年，铜箔、覆铜板等关键原材料价格随大宗商品价格波动，贵金属等部分辅材价格出现一定涨幅，部分板材价格在二季度末以来有所上浮，整体价格相对保持平稳。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>